

法規名稱：(廢)重要科技事業屬於製造業及技術服務業部分適用範圍標準
廢止日期：民國 88 年 12 月 31 日

第 1 條

本標準依促進產業升級條例第八條第三項規定訂定之。

第 2 條

重要科技事業之適用範圍，其屬製造業者，應符合下列各要件：

一、投資計畫生產之產品屬通訊工業、資訊工業、消費性電子工業、半導體工業、精密器械與自動化工業、航太工業、高級材料工業、特用化學品與製藥工業、醫療保健工業及污染防治工業，且未經申請重要投資事業之獎勵。

二、投資計畫之實收資本額或增加實收資本額新台幣二億元以上。

三、投資計畫之全新機器、設備購置金額新台幣一億元以上。

重要科技事業之適用範圍，其屬技術服務業者，應符合下列各要件：

一、投資計畫提供之技術服務屬前項第一款工業所需。

二、投資計畫之實收資本額或增加實收資本額新台幣五千萬元以上。

三、投資計畫之全新機器、設備購置金額如下：

(一) 核電廠維修及工程服務業、核能零組件驗證業、核電廠儀控系統之設計及更新業、輻射防護及監測業、核廢料處理業及產品工程服務業為新台幣一千五百萬元以上。

(二) 資訊軟體業、積體電路設計業、自動化工務服務業、環境保護工程及技術業、生物技術與製藥業服務業、節省能源之工程及技術服務業為新台幣七百萬元以上。

第一項第二款及前項第二款實收資本額，得於核定之投資計畫期間內分次增資、分次收足。第一項第三款及前項第三款之機器、設備，得於核定之投資計畫期間內分次購置。

公司之投資計畫應於符合重要科技事業適用範圍核准函核發之次日起三年內完成。

第 3 條

前條投資計畫生產之產品或提供之技術服務，其範圍如下：

一、通訊工業：

(一) 用戶設備：

1 電話機：

(1) 影像電話。

(2) 網際網路電話 (含 Internet gateway)

(3) 頻率 900 MHz 以上有線主機無線副機。

2 無線電對講機：Channel Space 小於 5MHz 者。

3 個人行動通訊產品 (呼叫器除外)。

4 無線按鍵電話系統。

5 無線數位式用戶交換機或內線五百門號以上之數位式用戶交換機。

6 普通紙傳真機。

7 全球定位系統。

8 整體服務數位網路用戶端設備。

(二) 局用設備：

- 1 數位式局用交換機。
- 2 行動電話系統。
- 3 智慧型網路設備。

(三) 傳輸設備：

- 1 數位式傳輸設備：(速率未達 64K bps之有線數據機及速率未達 1G bps之有線區域網路卡除外)。
- 2 非同步傳輸模式產品。
- 3 無線集群系統。
- 4 微波通訊設備。
- 5 衛星通訊設備(衛星直播接收設備除外)。

(四) 重要通訊產品零組件：

- 1 表面聲波濾波器、共振器、介質晶片型濾波器、積層晶片型濾波器。
- 2 通訊用射頻功率放大器(RF Power Amplifier)。
- 3 積體化模組元件(如積體化 DC Converter, Inverter 等高度 6 .75mm 以下之變壓元件)。
- 4 數位頻率合成器。
- 5 頻率達 800MHz 以上之鎖相迴路鎖頻器。
- 6 頻率達 800MHz 以上之射頻 IC 及其模組。
- 7 用於頻率 800MHz 以上之天線。
- 8 光電轉換器。
- 9 光纖維。
- 10 光傳輸發射接收模組。
- 11 光被動元件：
 - (1) 光纖耦合器。
 - (2) 光纖衰減器。
 - (3) 光纖濾波器。
 - (4) 光纖隔絕器。
 - (5) 光纖極化器。
 - (6) 光纖分波器。
 - (7) 光纖連接器。
 - (8) 光路切換器。
 - (9) 光纖準直器。
- (10) 光纖循環器。
- (11) 光纖波長多工器。
- (12) 光纖光柵。
- (13) 光纖放大器。
- (14) 光纖跳接及引線。
- (15) 關鍵零組件：
 - 光纖頭套及組件(外徑精度 $0.5\mu\text{m}$)。
 - 光纖連接器套管及組件(表面粗糙度最大值 $0.5\mu\text{m}$)。
 - 光學玻璃光纖光導線：單光纖維直徑 $50\mu\text{m}$ 以下，開放角度 82 度以上。
 - 熔合光纖面板：解析度一平方厘米 1000pixels 以上。
 - 光纖影像束：在 1mm Diameter 內解析度 4000pixels 支單光纖維以上。
- 12 傳輸頻率 300MHz 以上區域網路電纜(含伸線、蕊線押出、絞線

、被覆、測試)。

二、資訊工業：

(一) 電腦系統製造：

- 1 六十四位元以上之個人電腦。
- 2 CPU在 40MIPS 以上之工作站。
- 3 後置伺服器：需具有檔案服務、列印服務、資料庫服務、通信服務之任一功能者。
- 4 視訊會議設備。
- 5 個人數位助理器 (Personal Digital Assistant, PDA)：以具有通訊功能者為限。

(二) 週邊設備製造：

- 1 終端裝置：
 - (1) IC 卡讀寫機。
 - (2) 具有 Single Chip CPU且符合 ISO 7816 規定之 IC 智慧卡。
- 2 輸入裝置：
 - (1) 光學文字辨識裝置：如辨識中文者，應可辨識教育部公布之五四〇一常用中文字，辨識速度在每秒五字以上且辨識率在百分之九十以上。
 - (2) 指紋辨識器或語音辨識器 (可辨識四〇〇個以上之字彙且辨識率在百分之九十以上)。
 - (3) 彩色影像掃描器：光學解析度在六〇〇 DPI以上。
 - (4) 軌跡板：解析度一〇〇〇 DPI，輸入筆為無線電磁式，再現性 (絕對定位裝置) 為 -0.01~+0.01 吋。
 - (5) 觸控式輸入裝置：
曲面觸控屏：精確度±1 %以內，觸摸期間 3ms以內。
平面觸控屏：精確度±1 %以內，觸摸期間 3ms以內。
解析度一〇〇 DPI之非透明式手觸板 (Touch Pad)。
- 3 儲存裝置：
 - (1) 磁性記憶裝置：
三・五吋以下硬碟機。
三・五吋以下軟碟機。
 - (2) 光學記憶裝置：光碟機 (OPTICAL DISK DRIVER)。
 - (3) 半導體記憶裝置：符合 PCMCIA 規範之 IC 記憶卡。
- 4 輸出裝置：
 - (1) 十七吋以上彩色監視器或十四吋以上平面彩色監視器。
 - (2) 印表機 (撞擊式除外)。
- 5 三度空間虛擬實境設備 (3D/VR)：
 - (1) 計算處理裝置：限三維圖像處理卡、環場音訊卡 (3D Surround sound card)。
 - (2) 動態模擬機械裝置：以接受電腦指令而能模擬動態環境力量反應之多自由度運動平台 (Dynamic Simulation Mechanic Device) 為限。
 - (3) 立體輸入、輸出裝置 (3D Input/Output Device)：以三維滑鼠、三維軌跡球、三維掃瞄器、資料手套、頭盔、力感迴授裝置等產品為限。

(三) 重要精密零組件製造：

- 1 六十四位元以上之主機板。
- 2 MPEG II 壓縮、解壓縮裝置 (卡)。

- 3 磁碟機讀寫頭。
- 4 噴墨式或雷射式或電子成像頁印表機引擎、印表頭。
- 5 不中斷電力設備 (OFF-LINE除外) 。
- 6 硬碟機、掃描器之機構體：
- 7 腳距 1.27 公釐以下之電腦或通訊及週邊設備用精密連接器。
- 8 可充電式鋰電池、鎳氫電池。

三、消費性電子工業：

(一) 成品：

- 1 高畫質電視機：螢幕寬高比一六比九，水平掃描線七〇〇條以上（雙倍掃描者除外）。
- 2 數位電視機。
- 3 寬螢幕電視機或電視顯示器（需內裝調諧器）
- 4 彩色投影電視機或彩色影像投影系統。
- 5 以薄膜電晶體型液晶顯示器（TFT-LCD）為顯示螢幕之彩色液晶電視機。
- 6 數位視訊接收機。
- 7 有線電視系統用視訊伺服器。
- 8 數位式錄放影機。
- 9 彩色攝錄影機。
- 10 紅外線攝影機。
- 11 星光攝影機。
- 12 數位電子照像機。
- 13 雷射唱盤：以自行製造機構體者為限。
- 14 迷你音碟機。
- 15 影音光碟機（VCD PLAYER）或數位多功能光碟機（DVD PLAYER）。
- 16 視訊隨選系統。
- 17 自動對焦伸縮鏡頭照像機。
- 18 彩色數位相片印製系統。

(二) 關鍵零組件：

- 1 彩色影像管：以高解析度（0.28mm dot pitch以下）或二十九吋以上或螢幕寬高比一六比九者為限。
- 2 彩色影像管用玻璃面板、玻璃斗部。
- 3 彩色影像管用電子槍：能自製各種柵極（grid）、底座（stem）、陰極（cathode）、收集環（getter）等零件至少三種以上者。
- 4 彩色影像管用遮蔽罩用孔網。
- 5 音、影、光碟機機構體。
- 6 可寫式光碟片、可寫式磁光碟片、數位多功能唯讀光碟片。
- 7 三・五吋以下之硬碟機用磁碟片。
- 8 光學讀寫頭。
- 9 一一・三吋以上超扭轉矩陣型液晶顯示器或模組（以具玻璃面板製程為限）。
- 10 薄膜電晶體液晶顯示器或模組（以具玻璃面板製程為限）。
- 11 電激光平面顯示器（EL）。
- 12 五吋以上液晶顯示器用導光板或背光源組件（以具導光板製造為限）。
- 13 液晶顯示器用導電玻璃、彩色濾光膜、偏光膜（僅切割者除外）

- 。
- 14 自動對焦伸縮鏡頭。
 - 15 非球面精密模造鏡片。
 - 16 印刷電路板用電解銅箔（切割或上膠者除外）。
 - 17 銅箔基層板（玻璃態轉化溫度 T_g 170 °C 以上）。
 - 18 電子級玻璃纖維絲（細度 69 Tex 以下，並有抽絲設備者）、電子級玻璃纖維布（基重 110g/m²以下）
 - 19 數位式電視機用調諧器。
 - 20 偏向軛：以高解析度（0.28mm dot pitch以下）或高畫質電視機影像管用者為限。
 - 21 素箔蝕刻之電解電容器用電蝕鋁箔。
 - 22 變壓器、振盪器、電阻、電感、電容、二極體等二種或二個以上複合積體表面黏著元件。
 - 23 表面黏著積層電感。
 - 24 鈮鐵鋇磁石：(BH) max值在40MGOe以上。
 - 25 螢光顯示器（VFD）。
 - 26 電漿顯示器（模組組裝者除外）。
 - 27 音、影、光碟機主軸馬達。

四、半導體工業：

（一）半導體材料：

- 1 晶棒及晶圓、磊晶圓（含再生晶圓）。
- 2 積體電路用引線架：沖壓為一六〇腳以上；蝕刻為二〇八腳以上；球陣列矩陣基板（BGA）。
- 3 積體電路製程用光罩。

（二）半導體裝置：

- 1 積體電路製造或封裝（含覆晶）或測試。
- 2 彩色、紅外線電荷耦合元件（CCD）。
- 3 二〇〇 DPI以上之接觸式影像感測器。
- 4 太陽電池。
- 5 場發射平面顯示器（FED）。
- 6 電力電子元件：以Thyristor，TRIAC，GTO，Power MOS FET，頻率達 800MHz 以上之 FET，IGBT，SIT，SITH，MCT，電力用 BJT，高頻電力用電容器，高頻磁性元件用之鐵心等元件為限。
- 7 發光二極體晶粒（切割、紅光在 1F = 20mA 時封裝前亮度小於 40 mcd者除外）。
- 8 雷射二極體晶粒製造或製造與封裝。

五、精密器械與自動化工業：

（一）自動化生產系統：

- 1 彈性製造單元：具有刀流及物流之自動化加工設備，可藉由電腦之控制進行無人化生產之加工系統。
- 2 彈性製造系統：結合兩台以上加工機械、自動搬運系統及自動倉儲系統，並具有彈性加工能力及進行無人化生產之加工系統。
- 3 其他自動化生產系統：由中央管制電腦連線之生產系統，可監視及控制各單機之運轉者。
- 4 高速且非接觸式三次元掃描系統，其取像精度誤差小於〇・〇〇五公釐者。

（二）以 CNC或 PLC控制之精密工具機。

- (三) 具有自動控制功能之自動化產業機械。
- (四) 自動化物流及倉儲設備：以 CNC或 PLC控制，可自動輸送及存取者為限。
- (五) 自動調控溫度之熱處理設備。
- (六) 能源監控系統。
- (七) 供應輸配電網路使用之電力調度、配電自動化系統及其週邊設備。
- (八) 全自動操作之自動化包裝機械。
- (九) 螺旋式、渦卷式、離心式空氣壓縮機。
- (十) 鍋爐：每小時蒸發量達一〇〇噸以上者。
- (十一) 機器人：四軸以上，且由 CNC控制、運動軌跡可編輯並能重現者。
- (十二) 精密機械零組件、自動化零組件：
 - 1 供自動化機械用之空、油壓組件。
 - 2 符合 CNSO 級以上之精密軸承。
 - 3 經熱處理或研磨之精密齒輪。
 - 4 滾珠螺桿：精度誤差小於 0.005 公釐/ 300 公釐者。
 - 5 線性滑軌：移動平行度誤差小於 0.016 公釐/ 300 公釐者。
 - 6 內藏式主軸：轉速達 8000 轉/分鐘以上者。
 - 7 具 CPU三十二位元以上電腦數值控制器。
 - 8 沖壓或鑄鍛或橡塑膠用精密模具。
 - 9 錶芯。
 - 10 數位式變頻器。
 - 11 可程式邏輯控制器。
 - 12 分散式控制系統。
 - 13 冷媒壓縮機（往復式者除外）。
 - 14 伺服、步進、變頻、交換磁阻式馬達。
 - 15 數位式交流伺服驅動系統。
 - 16 八吋以上晶圓製程用石英器具。
 - 17 精密微鑽頭：直徑 0.3 公釐以下者。
 - 18 質流控制閥（MFC）：洩漏量 10^{-10} （負 10 次方）atm.cc/sec 以下。
 - 19 乾式真空泵浦：真空度 10^{-4} （負 4次方）torr 以下。
- (十三) 精密動力、傳動、制動系統：
 - 1 汽車引擎：
 - (1) 噴射泵。
 - (2) 液化石油氣燃料系統。
 - 2 防鎖煞車系統。
 - 3 安全氣囊系統。
 - 4 汽、機車引擎電子控制單元：
 - 5 汽車動力轉向液壓泵。
 - 6 汽車自動變速箱總成。
 - 7 觸媒轉換器。
 - 8 機車引擎：配合整車測試符合四期環保法規標準。
 - 9 機車化油器：配合整車測試符合四期環保法規標準。
 - 10 電動汽車。
 - 11 電動機車。
 - 12 電動自行車。

- 13 殘障用特製電動代步車：符合美國 FDA醫療用品規範或歐盟 CE 產品標準。
 - 14 電動汽、機車及自行車重要零組件：
 - (1) 馬達：輸出功率須達三瓩以上且功率密度須高於 0.3 瓩/公斤 。
 - (2) 能量密度達三五瓦特小時／公斤（三小時放電率）以上之鉛酸電池。
 - (3) 控制系統。
 - 15 複合動力汽車：油耗效率在 FTP75模式下需達 28 km/1 以上，C排放標準在 FTP75模式下需達 125g/km 以下。
 - 16 電動車路邊充電設備。
 - 17 電聯車。
 - 18 軌道車輛重要次系統與零組件：
 - (1) 車輛機械系統。
 - (2) 轉向架總成。
 - (3) 動力及電力控制設備。
 - (4) 行車安全控制設備。
 - (5) 場站營運設備。
 - 19 自行車變速器：
 - (1) 飛輪：上鏈機率 90% 以上，下鏈機率 60% 以上，齒片偏擺， 0.2mm 以內。
 - (2) 後變速器：斜平行四連桿式，彈簧回復力之降低率須在 30% 以內，疲勞壽命：往復二萬次不破壞。
 - (3) 前變速器：機構晃動量（彈簧去除後）：尾端晃動量 5mm 以內（作用力 10kgf ），疲勞壽命：往復五千次不破壞，作動力變化率小於 30% ，撥鏈力量：全行程 4.5kgf 以上。
 - (4) 曲柄與大齒盤總成：齒片偏擺： 0.4mm 以內。
 - (5) 自行車內變速器：四速以上、傳動效率 91% 以上、重量（含齒片、不含轂式或倒踩煞車） 1.5 kg 以下、速比變化範圍（以內變速器單體評估） 240% 以上及變速操作力在 7kgf 以下。
 - 20 精密檢測設備及零組件：
 - (1) 電子量測儀器（不含測試頻率在 1MHz 以下之電感電容阻抗測試器顯示有效位數低於五位半之多用電錶非合成信號函數波型產生器）。
 - (2) 通訊量測儀器。
 - (3) 光電檢測儀器。
 - (4) 自動化測試儀器。
 - (5) 精密量測儀器（不含分度低於萬分之一的電子秤）。
 - (6) 精密檢測零組件。
 - 21 汽車導航設備。
- (十四) 發電設備：
- 1 渦輪發電機組及其附屬設備與零組件。
 - 2 水輪發電機組及其附屬設備與零組件。
 - 3 風力發電機組及其附屬設備與零組件。
 - 4 太陽能發電系統及其附屬設備與零組件。
 - 5 電廠控制系統：使用可程式控制系統或分散式控制系統者。
- (十五) 輸電設備：

- 1 六九 KV 以上之電力電纜。
- 2 六九 KV 以上之電纜接頭。
- 3 複合光纖電纜。
- 4 礙子：22kv 以上或 11kv 以上複合材質者。

(十六) 變電設備：

- 1 一六一KV級以上電力變壓器。
- 2 瓦斯絕緣變壓器。
- 3 瓦斯絕緣電力電容器。
- 4 瓦斯絕緣開關設備。
- 5 絕緣套管。
- 6 交換式直流供電設備：工作頻率在 40KHz以上，單機三相效率在百分之九十以上、單相效率在百分八十五以上，並具有監控單元及界面者為限。

(十七) 配電設備：

- 1 非晶質鐵心變壓器。
- 2 配電級瓦斯絕緣變壓器。
- 3 瓦斯絕緣開關及斷路器。
- 4 二二 KV 級電纜接頭。
- 5 電子式電價錶。
- 6 電子式電磁開關、電磁接觸器。
- 7 電子式無熔線開關、漏電斷路器。
- 8 真空斷路器 VCB (3.3 KV以上)。
- 9 玻纖纏繞強化乾式變壓器 (24KV以上)。
- 10 模鑄式匯流排。

(十八) 節約能源設備：

- 1 省電燈管、燈泡：以球形日光燈、PL 燈及 BB 燈為限。
- 2 電子式安定器。
- 3 吸收式空調設備。
- 4 省能源、智慧型電器設備：以 Inverter，Fuzzy或 Neural 方式控制或其他經由經濟部能源委員會認定具有百分之十五以上省能效益之設備者為限。
- 5 陶磁變壓器陶瓷晶片放電管。

(十九) 同位素生產及民生應用設備：以向行政院原子能委員會申請認定並經經濟部工業局核發證明者為限。

(二十) 光纖照明系統。

六、航太工業：

- (一) 飛機。
- (二) 機體結構及其零組件。
- (三) 發動機及其零組件。
- (四) 航空電子設備。
- (五) 航空液壓設備。
- (六) 航空電氣設備。
- (七) 專用維修及製造設備。
- (八) 地面導航通訊裝備。
- (九) 衛星本體及其相關設備。
- (十) 飛機內裝產品及設備：以通過國際主要航空認證機構認證者為限。
- (十一) 飛機維修與改裝：以通過國際主要航空認證機構認證者為限。
- (十二) 飛航及航管訓練設備：

- 1 飛航模擬機。
- 2 航電訓練設備模擬機。

七、高級材料工業：

(一) 特殊合金鋼：以具備精煉設備如 AOD、VOD、ESR、LF 等之一者為限或以具備全自動軋製設備或具備自動控溫熱處理設備或異型棒材精密冷抽加工設備者為限。

1 工具鋼：

- (1) 合金工具鋼。
- (2) 高速工具鋼。

2 構造用合金鋼：

3 特殊用途鋼：

- (1) 彈簧鋼。
- (2) 軸承鋼。
- (3) 不鏽鋼（材質 304、304L、316、316L 除外，惟厚度 0.15mm 以下鋼捲或直徑 0.05mm 以下細線仍准予適用）。
- (4) 耐熱鋼。
- (5) 快削鋼。
- (6) 高張力鋼。
- (7) 鋼琴線材。
- (8) 高錳鋼。

(二) 電磁鋼片：具備軋製設備且產品鐵損值達五瓦特／公斤以下者。

(三) 非晶質磁性材料及鐵心。

(四) 超合金：以具備精煉設備如 VIM、VAR 等一者為限或具備全自動軋製或鍛製設備或粉末製造設備為限。

- 1 鈦合金。
- 2 鎳基合金。
- 3 鈷基合金。
- 4 儲氫合金。

(五) 鎂合金：

- 1 鎂合金錠、粒：具備精煉設備或粉粒製造設備者。
- 2 鎂合金件：產製鎂合金零組件。

(六) 鋁合金：

- 1 鋁合金板片：具備熱軋及冷軋設備者或產製國防、航太及運輸工具用之合金系列之板片捲者。
- 2 鋁箔。

(七) 銅合金：

- 1 銅合金板片：以具備熱軋及冷軋設備為限；材質以磷青銅或磷鐵黃銅或磷鐵青銅或銅鎳合金為限。
- 2 銅箔：以具備熱軋及冷軋設備；材質以紫銅或磷銅或青銅為限。
- 3 冷氣機使用之螺紋銅管。

(八) 鑄造品：

- 1 球狀石墨鑄鐵：具備機械化造模或沃斯回火處理設備者。
- 2 耐磨鑄鋼：具備機械化造模設備者。

(九) 高性能塑橡膠：以由單體一貫聚合者為限。

- 1 低吸濕性聚醯胺塑膠 (Polyamide) (吸水率小於 1.0%)。
- 2 聚碳酸酯 (PC)。
- 3 變性聚氧化二甲苯 (M-PPO)。
- 4 聚硫化二甲苯 (PPS)。

- 5 液晶高分子 (LCP) 。
- 6 聚醯亞胺 (PI) 。
- 7 熱可塑性氟素樹脂 (PVDF、PTFE、PFA等) 。
- 8 芳香族聚酯 (PAR) 。
- 9 對位聚苯乙烯 (sPS) 。
- 10 聚 二甲酸二乙酯 (PEN) 。
- 11 超高分子量聚乙烯 (分子量 1×10^6 (6次方) 以上) 。
- 12 新世代聚烯烴塑膠

Metallocene Based Polyolefins :

- (1) 新世代聚乙烯 mPE 。
 - (2) 新世代聚丙烯 mPP 。
 - (3) 新世代環聚烯 mCOC 。
- 13 高性能橡膠
 - (1) 矽橡膠。
 - (2) 乙烯－丙烯－共軛二烯橡膠 (mEPDM) 。

(十) 高級纖維材料工業：

- 1 超細纖維：單一成分紡絲聚酯纖維單纖細度小於或等於 0.3丹尼，單一成分紡絲非聚酯纖維單纖細度小於或等於 1.0丹尼，多成分複合紡絲單纖細度小於或等於 0.01 丹尼，並裝置有抽絲設備者。
- 2 高強力纖維：纖維強度大於 10g/d，並裝置有抽絲設備者。
- 3 耐燃纖維：LOI值大於三十之有機纖維，並裝置有抽絲設備者。
- 4 彈性纖維：彈性伸長五倍以上，並裝置有抽絲設備者。
- 5 透濕防水布：透濕度 5000g/m²/天，或耐水度達 5000 公釐／水柱。
- 6 多功能高層次不織布：且有紡粘製程（纖維細度 10 micron以下）、熔噴製程（纖維細度1 micron以下，且其產品具電池隔離模功能者）及熱粘製程者。
- 7 新溶媒纖維素纖維：溶劑型新溶媒纖維素纖維且強度為 4g/d以上者，並裝置有抽絲設備者。
- 8 抗靜電纖維：電阻 10¹⁰（負 3次方）歐姆～ 10⁸（負 8次方）歐姆／c，並裝置有抽絲設備者。
- 9 環保纖維：為生物可分解之合成纖維，並裝置聚合與抽絲設備者。

(十一) 厚度一．一公釐（含）以下之微薄玻璃板。

(十二) 核燃料製造：以向行政院原子能委員會申請認定並經經濟部工業局核發證明者為限。

- 1 壓水式反應器核燃料。
- 2 沸水式反應器核燃料。

八、特用化學品與製藥工業：

(一) 特用化學品：

- 1 氟碳化合物類：
 - (1) 二氟甲烷。
- 2 胺基酸類：
 - (1) 苯丙胺酸 (Phenylalanine) 。
 - (2) 色胺酸 (Tryptophan) 。
 - (3) 脯胺酸 (L-Proline) 。

3 固定化酵素或細胞。

4 乙醇胺。

5 高分子類：

(1) 水性聚氨基甲酸乙酯 (PU) 樹脂。

(2) 水性環氧樹脂。

(3) 氟素及矽系樹脂。

6 助劑及添加劑：

(1) 食品及醫藥用：

六甲基二矽胺 (Hexamethyl - disilazine) 等矽烷化劑。

疫苗之佐劑。

核 酸。

(2) 工業用：

紡絲油劑。

PVC用丙烯酸系塑膠改質劑。

有機磷系耐燃劑 (以原料一貫合成者為限)。

金屬元素及其化合物：以金屬為原料一貫生產者為限。

a 鋰：以具備冶煉設備可完成初生鋰者為限。

b 鋰電池用鋰電解質。

c 鹼金屬烷基化合物及烷基氧化物、氯化鋰、四氯化鋰鋁。

d 烷基或芳香烴基鎂鹵化物。

e 銻鹽。

f 銦或鈦金屬粉：以還原法由氧化銦或氧化鈦製得，其平均顆粒小於十微米 (10 microns)。

g 鋇或鋇鋁合金：以融溶法製成，其純度達九八·九%以上者。

1,3-丙烷磺酸內酯及其衍生物：以原料一貫合成生產者為限。

二甲基二丙烯基氯化銨及其衍生物：以原料一貫合成生產者為限。

光起始劑：

a 異丙基塞吨酮 (Isopropyl Thioxanthone)。

b (α -取代烷基) 苯基酮

(α -substituted alkyl) phenylketone 等系列產品。

7 電子用化學品：

(1) 矽晶圓及積體電路用高純度洗淨液、氣體及蝕刻劑：各金屬離子含量在 5ppb 以下且微粒子大於 $0.5\mu\text{m}$ 者低於或等於30顆粒以下者為限。

(2) 薄膜電晶體型液晶顯示器 (TFT\LCD) 用高純度洗淨液、蝕刻劑及剝離劑：各金屬離子含量在 1ppm 以下者為限。

(3) 積體電路及光碟片用高純度剝離劑：各金屬離子含量在 100ppb 以下且微粒子大於 $0.5\mu\text{m}$ 者低於或等於 30 顆粒以下者為限。

(4) 印刷電路板用黑化處理劑。

(5) 有機電激發光顯示器用有機發光二極體 (OLED) 發光材料，電子、電洞傳輸材料、介電材料。

(6) 光阻劑：(符合下列之一條件者)

以X射線、電子束 (E-beam) 或紫外線波長四三六 nm 以下照射或線寬 3μm 以下者為限。

以電著方式塗佈者為限。

液晶顯示器用彩色光阻劑：以顏料分散型為限。

- (7) 研磨液及研磨墊：晶圓拋光用或積體電路中氧化層、金屬膜、低介電層研磨用為限。
- (8) 積體電路用封裝材料：以低應力型、低介電值 ($dk < 3.5$) 或薄型為限。
- (9) 積體電路用顯影劑：
濃度未滿 3% (W/W) 者，各金屬離子在 1ppb 以下。
濃度在 3% (含) (W/W) 以上者各金屬離子需在 5ppb 以下。
- (10) 增層式 (Build up) 印刷電路板介電絕緣基材。
- (11) 積體電路用導電接著劑。
- (12) 光碟記錄層用染料或光學化抑制劑 (或安定劑)。
- (13) 可充電式鋰電池或鎳氫電池用正負極材料。
- (14) 電磁波隔絕防護層 (Electro Magnetic Interference Shield)：採選擇性無電解金屬吸附法，使用幾丁聚醣或其他非金屬吸附介質之聚合膜為限。
- (15) 晶片尺寸構裝 (CSP) 用高分子三層式薄膜基材 (以 PI 或 LCP 膜為主、應用球距在 0.5mm 以下者)。
- (16) 六方氮化硼、立方氮化硼、聚晶氮化硼。

8 顏料中間體：

- (1) 5- (2'-羥基-3'-萘氨基) - 苯並咪唑酮
(5- (2'-Hydroxy-3'-naphthoylamino) - benzimidazolone) 及其衍生物 (以原料一貫合成生產者為限)。
- (2) 5-乙酰乙醯氨基 -2- 苯並咪唑酮。
(5-Acetoacetyl amino -2-benzimidazolone) 及其衍生物 (以原料一貫合成生產者為限)。

9 其他：

- (1) 金屬醇鹽、非金屬醇鹽或無機鹽溶膠及凝膠 (Sol-Gel)：以金屬醇鹽、非金屬醇鹽或無機鹽為原料一貫製造者，其製成品紫外線吸收率為九十%以上，紅外線吸收率達六十%以上，透光率達九十%者為限。
- (2) 預塗式感光平版：以成卷方式連續塗佈生產者。
- (3) 精碳材料：球狀結晶介相瀝青粉末或膨脹性石墨粉末。
- (4) 幾丁質、幾丁聚醣。
(Chitin、Chitosan)
- (5) 矽橡膠用交聯劑。
- (6) 農業用生物製劑
微生物殺蟲劑 (以醱酵法產製者為限)。
微生物殺菌劑 (以醱酵法產製者為限)。
生長調節劑 (以醱酵法產製者為限)。

(二) 製藥：

1 原料藥中間體：

- (1) 光學活性中間體。
- (2) (D)-4-羥苯基胺基乙酸 ((D)-4-Hydroxyphenyl Glycine)。

2 原料藥：

- (1) 抗菌劑：以Cephalosporins, Fluoroquinolone, Fluconazole 系列為限。

- (2) 維生素。
- (3) 心臟血管用原料藥。
- (4) 消化系統用原料藥（以潰瘍癒合劑為限）。
- (5) 抗癌原料藥。
- (6) 光學活性原料藥。
- (7) 蛋白質或胜 類原料藥。
- (8) 中樞神經用原料藥。

3 製劑：

- (1) 西藥製劑：
 - 經皮吸收製劑。
 - 釋放控制型製劑。
 - 抗癌製劑。
 - 罕見疾病用（孤兒）藥（經行政院衛生署核准者為限）
- (2) 中藥製劑（經臨床實驗證明療效者）。
- (3) 生物製劑：
 - 蛋白質或胜 製劑。
 - 血液製劑。
 - 疫苗：
 - a 人用疫苗。
 - b 動物用疫苗（以新劑型者為限）。

九、醫療保健工業：

（一）診療保健儀器：

- 1 超音波診斷儀：頻率範圍 2.0MHz 以上。
- 2 攜帶式血糖分析儀：與生化分析儀之相關數比較，誤差值百分之十五以內。
- 3 心電圖機：具自動分析功能及心電圖記錄器：三導程以上（一般式）；二導程以上（攜帶式）。
- 4 輻射醫療設備（核輻射、熱輻射）。
- 5 血液分析儀：可測量血球數量等血液分析項目，分析項目包括（WBC、RBC、HGB或 PLT項目）。
- 6 生化分析儀：具測試全血、血清、血漿、尿液、脊髓液或唾液之化學成份功能之一者。
- 7 自動化臨床生化檢驗系統：具自動取像系統、自動液體輸送、數據自動擷取保存及處理等功能。
- 8 生理監視系統：具心電圖／呼吸、血壓、血氧濃度等參數之模組。
- 9 核醫藥物及設備。
- 10 血液病菌培養設備：可培養血液中之病菌或微生物，以利檢測查覺病源者。
- 11 雷射醫療設備。

（二）檢驗試劑：

- 1 免疫分析檢驗試劑。
- 2 核探針針檢驗試劑。

（三）生醫材料及元件：

- 1 硬組織（人工關節、骨骼及補骨等）。
- 2 軟組織（人工韌帶、血管、皮膚等）。
- 3 液態組織（人工血液、脂肪液等）。
- 4 人工器官（心瓣膜、心臟、腎臟、眼球水晶體等）。

- 5 血液接觸管帶類元件（血袋、真空採血器、洗腎器等）。
- 6 創傷覆蓋材。
- 7 抗組織沾粘材料。
- 8 生物晶片（Bio-chip）。
- 9 生物感測器（Biosensor）。

（四）醫療器具：

- 1 安全注射針筒（限射針縮入針筒式者為限）。
- 2 醫療手套（乳膠及聚氯乙烯製者除外）。

十、污染防治工業：

（一）廢棄物處理設備：

- 1 焚化爐、熱解爐或其他高效率熱處理設備。
- 2 前項設備所需之進料機、燃燒機。
- 3 資源化再生利用及回收處理設備。
- 4 生物處理設備。

（二）偵測檢驗設備：

- 1 自動連續監測設備。
- 2 PH 值、溫度、溶氧、導電度等感應電極。
- 3 光電監測儀器。
- 4 聲學偵測儀器。
- 5 超音波流量計。

（三）處理機器設備及零配件：

- 1 污水泵、污泥泵：五匹馬力以上，處理能力十立方公尺／小時以上。
- 2 細篩機：孔徑○·五公釐以內，處理能力一百立方公尺／小時以上。
- 3 離心式鼓風機：六十匹馬力以上，處理能力每分鐘五十立方公尺以上。
- 4 曝氣機：於四公尺水深其傳氧效率達二十％以上。
- 5 雙液式污泥脫水機。
- 6 逆滲透過濾機、超微過濾機。
- 7 廢水氧化處理用臭氧發生機。
- 8 廢水氧化處理用紫外線燈管。
- 9 材質耐溫在攝氏二百五十度以上之濾袋。
- 10 靜電集塵器之 子、高壓整流器。

（四）材料及處理劑：

- 1 廢水處理用生物製劑、生物載體。
- 2 活性碳（製造及再生）。
- 3 廢水、廢氣處理用離子交換樹脂。
- 4 污泥脫水機用濾布。
- 5 廢水、廢氣處理用沸石。
- 6 廢水、廢氣處理用觸媒。
- 7 廢棄物掩埋場滲液阻隔膠布或不透水布。
- 8 噪音防制材料。

十一、技術服務業：

（一）資訊軟體：

- 1 套裝軟體（含應用軟體、系統軟體、網路多媒體軟體）。
- 2 專業服務。
- 3 轉鑰系統。

- 4 系統整合。
- (二) 積體電路設計。
 - (三) 自動化工程服務：經經濟部工業局審查合格，並登錄之「自動化工程服務機構」。
 - (四) 核電廠維修及工程服務：以向行政院原子能委員會申請認定並經經濟部工業局核發證明者為限。
 - (五) 核能零組件驗證：以向行政院原子能委員會申請認定並經經濟部工業局核發證明者為限。
 - (六) 核電廠儀控系統之設計及更新：以向行政院原子能委員會申請認定並經經濟部工業局核發證明者為限。
 - (七) 輻射防護及監測：以向行政院原子能委員會申請認定並經經濟部工業局核發證明者為限。
 - (八) 核廢料處理：以向行政院原子能委員會申請認定並經經濟部工業局核發證明者為限。
 - (九) 環境保護工程及技術：指專門從事下列業務之一者。
 - 1 領有環境保護工程業登記證照，從事承攬製造業之水污染防治、空氣污染防制、噪音及振動防治、廢棄物清理、土壤污染防治或環境監測工程之設備安裝、施工、維護檢修、代操作等業務之一。
 - 2 從事新污染防治技術之研究開發。
 - 3 經環保主管機關依公民營廢棄物清除處理機構管理輔導辦法許可之廢棄物處理機構及甲級清除機構。
 - (十) 產品工程服務：指從事本標準第二條第一項第一款所定重要科技事業生產產品之設計或測試等服務業務。
 - (十一) 生物技術與製藥業服務：從事藥物臨床前或臨床試驗、研究、測試服務或生體可用率及生體相等分析試驗之事業。適用標準：公司至少要有專職大專學歷五人以上研發人員。
 - (十二) 節省能源之工程及技術服務：以向經濟部能源委員會申請認定者為限。

第 4 條

符合第二條規定之公司，如需適用重要科技事業獎勵，應於下列規定期間內，向經濟部工業局申請核發符合重要科技事業適用範圍核准函：

- 一、投資計畫之機器、設備安裝地位於科學工業園區或加工出口區內者，屬新投資創立者於公司執照核發之次日起六個月內；增資擴充之公司於增資變更核准之公司執照核發之次日起六個月內。
- 二、投資計畫之機器、設備安裝地位於科學工業園區或加工出口區以外者。

- (一) 屬製造業者，新投資創立之公司於工廠設立許可函核發之次日起六個月內；增資擴充之公司於增資變更核准之公司執照核發之次日起六個月內。
- (二) 屬技術服務業者，新投資創立之公司於公司執照核發之次日起六個月內；增資擴充之公司於增資變更核准之公司執照核發之次日起六個月內。

三、投資計畫之機器、設備安裝地跨前二款區域者：

- (一) 屬製造業者，新投資創立之公司於公司執照或工廠設立許可函核發之次日起六個月內；增資擴充之公司於增資變更核准之公司執照核發之次日起六個月內。

- (二) 屬技術服務業者，新投資創立之公司於公司執照核發之次日起六個月內；增資擴充之公司於增資變更核准之公司執照核發之次日起六個月內。

前項增資變更核准之公司執照，於分次增資時，以第一次增資變更核准之公司執照為準。

經濟部工業局於核發第一項核准函時，應副知第六條第一項規定之受理核發完成證明機關、財政部賦稅署及公司所在地之稅捐稽徵機關。

第 5 條

公司依第四條規定申請核發符合重要科技事業適用範圍核准函時，應檢具下列文件：

一、投資計畫之機器、設備安裝地位於科學工業園區或加工出口區內者：

- (一) 入區投資核准函影本。
- (二) 公司執照影本。其屬增資擴充者，為增資前後公司執照影本。
- (三) 投資計畫書七份。

二、投資計畫之機器、設備安裝地位於科學工業園區或加工出口區以外者：

- (一) 公司執照影本。其屬增資擴充者，為增資前後公司執照影本。
- (二) 屬製造業者，新投資創立之公司另須檢附工廠設立許可函影本，增資擴充之公司須檢附工廠登記證影本。
- (三) 投資計畫書七份。

三、投資計畫之機器、設備安裝地跨前二款區域者：

- (一) 入區投資核准函影本。
- (二) 公司執照影本（其屬增資擴充者，為增資前後公司執照影本）或工廠設立許可函影本。
- (三) 工廠登記證影本（新投資創立之公司免附）。
- (四) 投資計畫書七份。

前項投資計畫書格式，由經濟部工業局定之。

第 6 條

經核發符合重要科技事業適用範圍核准函之公司，應於核定之完成期限內完成投資計畫，並於完成後檢具相關文件，依下列規定申請核發完成證明。

一、投資計畫之機器、設備安裝地位於科學工業園區內之公司，向科學工業園區管理局為之。

二、投資計畫之機器、設備安裝地位於加工出口區內之公司，向加工出口區管理處為之。

三、投資計畫之機器、設備安裝地位於科學工業園區及加工出口區以外者，位於直轄市內之公司，向當地市政府建設局為之；位於直轄市以外之公司，向經濟部工業局為之。

四、投資計畫之機器、設備安裝地如跨前三款之區域者。應以購置金額較高之機器、設備安裝地為準，分別依前三款規定程序辦理。

前項完成證明之格式，由經濟部工業局定之。

第一項主管機關於核發完成證明時，應副知財政部賦稅署及公司所在地之稅捐稽徵機關。

第一項之施行期間，自八十八年七月一日起至八十八年十二月三十一日止。

第 7 條

公司依第六條規定申請核發完成證明時，應檢附下列文件：

一、投資計畫之機器、設備安裝地位於科學工業園區或加工出口區內者：

- (一) 經濟部工業局核發符合重要科技事業適用範圍核准函影本。
- (二) 機器、設備清單六份。
- (三) 機器、設備配置圖。
- (四) 公司執照影本。其屬增資擴充者為增資前後公司執照影本。
- (五) 設立或資本額變更登記之營利事業及工廠登記證影本。
- (六) 購置機器、設備之統一發票影本、海關進口相關證明文件影本或會計師查核證明文件。
- (七) 募集現金資本之相關證明文件。
- (八) 議決廳投資計畫第一次增資之股東會或董事會會議紀錄影本；屬新投資創立者，為發起人會議紀錄影本。

二、投資計畫之機器、設備安裝地位於科學工業園區及加工出口區以外者：

- (一) 經濟部工業局核發符合重要科技事業適用範圍核准函影本。
- (二) 機器、設備清單六份。
- (三) 機器、設備配置圖。
- (四) 公司執照影本。其屬增資擴充者為增資前後公司執照影本。
- (五) 設立或資本額變更登記前後之工廠登記證影本。其屬技術服務業者為設立或資本額變更登記前後之營利事業登記證影本。
- (六) 機器、設備辦妥工廠變更登記核准函影本（技術服務業免附）。
- (七) 購置機器、設備之統一發票影本、海關進口相關證明文件影本或會計師查核證明文件。
- (八) 募集現金資本之相關文件。
- (九) 議決該投資計畫第一次增資之股東會或董事會會議紀錄影本；屬新投資創立者，為發起人會議紀錄影本。

三、投資計畫之機器、設備安裝地跨前二款區域者，應檢附該二款各目所列之文件。

第 8 條

經核發符合重要科技事業適用範圍核准函之公司，未能於經濟部工業局核定之期限完成投資計畫或投資計畫產品變更者，應於核定完成日期前向經濟部工業局申請展延或變更。但全程計畫完成期限不得超過四年。

經濟部工業局於核定計畫展延或產品變更時，應副知第六條第一項規定之受理核發完成證明機關、財政部賦稅署及公司所在地之稅捐稽徵機關。

第 9 條

第三條之適用範圍遇有刪除或修正時，公司仍得自刪除或修正生效之當日起六個月內，向經濟部工業局申請適用本標準。

第 10 條

經核發符合重要科技事業適用範圍核准函之公司、於提出申請核發完成證明後，經受理機關實地勘查投資計畫已屬完成，未及核發完成證明前遭受地震、風災、水災、旱災、蟲災、火災及戰禍等不可抗力災害者，受理機關仍得依據原完成狀態，核發其完成證明。

第 11 條

本標準施行期間除另有規定者外，自八十八年一月一日起至八十八年十二月三十一日止。